

# PLC-2147 RFタイプ (type) (銀スルーホール対応、鉛フリーはんだリフロー対応材)

(Silver through hole, For lead free solder)



## 特長

- (1)高耐熱性に優れ、高融点の鉛フリーのはんだを使用するリフローによる実装を可能にしました。
- (2)高度な耐湿性、電気絶縁性を有し、耐銀移行性に優れています。銀スルーホール、銀ジャンパー等の回路を有するプリント配線板に適しています。
- (3)高温焼き付け条件での反り、ねじれが小さく安定しています。印刷抵抗等の、高温長時間焼き付けの繰り返される用途に適しています。

## Features

- (1)It is excellent in heat resistance, and enable the surface mounting of reflow machine by use lead free solder.
- (2)Excellent migration resistance to silver, having high humidity resistance and electric insulation. Suited for printed circuit boards having circuits of silver through-holes, silver jumpers,etc.
- (3)Warp and twist are small and stable under high-temperature baking conditions. Suited for repeated baking under high-temperature and for long period, such as printing resistors.

## リフロー耐熱性

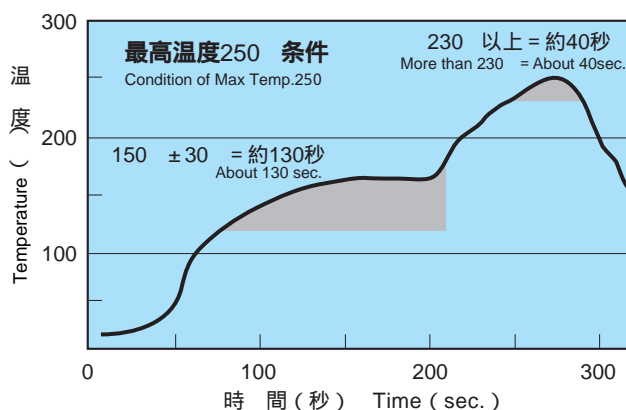
Reflow Heat Resistance

プレヒート150～180 Pre-heat 150～180		約100秒 About 100 seconds			
本加熱部230 以上 Heat temperature shall be kept more than 230		約27秒 About 27 seconds	約32秒 About 32 seconds	約40秒 About 40 seconds	約42秒 About 42 seconds
銅箔表面の最高温度 The max temperature on the surface of copper		240	245	250	255
鉛フリー対応材 PLC-2147 RFタイプ Lead free solder materia PLC-2147 RF type	1回目 First time	○	○	○	○
	2回目 Second time	○	○	○	○
一般銀スルー材 PLC-2147 RHタイプ Conventional silver-TH material PLC-2147 RH type	1回目 First time	○	○	○	○
	2回目 Second time	○	○	×	×

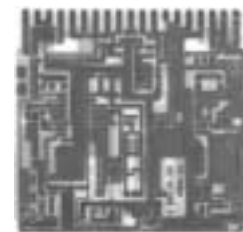
: 膨れ、剥がれ無し  
: No Delamination

## 温度プロファイルの設定例

An example of setting up temperature profile



基板：100×100mm 弊社TP  
 ・PWB：100×100mm Sumitomo's own TP  
 SR加工無し 銀焼成工程想定  
 No SR treatment Estimation of silver paste curing process  
 E-1/150



・リフロー機 / エアリフロー-TAR30-36LH(タムラ製作所社製)  
 Reflow Machine / Air Reflow-TAR30-36LH(TAMURA Corp.)